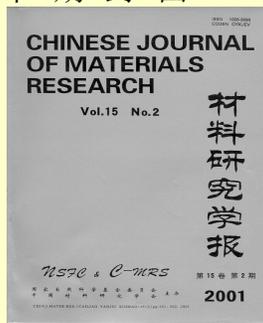


## 本期封面



2001年2

栏目:

DOI:

论文题目: Bi<sub>0.5</sub>Sb<sub>1.5</sub>Te<sub>3</sub>/聚苯胺复合材料的制备及电学性能

作者姓名: 胡淑红, 赵新兵, 朱铁军, 周邦昌

工作单位: 浙江大学硅材料国家重点实验室

通信作者: 胡淑红

通信作者Email:

文章摘要: 用机械共混法制备了Bi<sub>0.5</sub>Sb<sub>1.5</sub>Te<sub>3</sub>/聚苯胺复合材料, 测量了材料的电学性能参数. 与Bi<sub>0.5</sub>Sb<sub>1.5</sub>Te<sub>3</sub>相比, 复合材料的Seebeck系数略有下降. 在290~300K温区内, 复合材料的电导率随材料中聚苯胺含量的增加呈线性下降趋势. 在室温下, 聚苯胺加入量(质量分数)为2%的复合材料, 其功率因子比Bi<sub>0.5</sub>Sb<sub>1.5</sub>Te<sub>3</sub>的低约30%.

关键词: Bi<sub>0.5</sub>Sb<sub>1.5</sub>Te<sub>3</sub>; 聚苯胺; 无机/有机复合材料

分类号:

关闭